

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号:2024-025

债券代码：113602

债券简称：景 20 转债

债券代码：113669

债券简称：景 23 转债

深圳市景旺电子股份有限公司

关于预计2024年度向银行申请综合授信及银团贷款

暨为子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称：全资子公司江西景旺精密电路有限公司（以下简称“江西景旺”）、景旺电子科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海景旺”）、景旺电子科技（龙川）有限公司（以下简称“龙川景旺”）、控股子公司珠海景旺柔性电路有限公司（以下简称“珠海景旺柔性”）
- 本次预计担保金额及已实际为其提供担保的余额：本次预计担保金额为 33.30 亿元，已实际为上述子公司提供担保的余额为 28.00 亿元。
- 担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次提供担保事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。

一、申请综合授信额度及银团贷款情况概述

（一）申请综合授信情况概述

为满足深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司的项目建设及生产经营资金需求，公司及子公司 2024 年度拟向银行申请合计不超过人民币 64.40 亿元的综合授信额度。综合授信额度品种包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。具体授信额度以公司办理的实际业务、与银行签署的相关协议为准。上述授信额

度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。

（二）申请银团贷款情况概述

1、为满足公司景嘉智能制造大厦项目建设资金需求，公司拟向中国银行股份有限公司深圳南头支行（以下简称“中国银行深圳南头支行”）、中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中国民生银行深圳分行”）、中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中国光大银行深圳分行”）申请总额度不超过 16.00 亿元、期限不超过 120 个月的中长期银团贷款，其中中国银行深圳南头支行作为银团牵头行及代理行，承贷份额不超过 8.00 亿元、中国民生银行深圳分行承贷份额不超过 4.80 亿元、中国光大银行深圳分行承贷份额不超过 3.20 亿元。公司拟以持有的位于深圳市宝安区燕罗街道牛角路东北侧的土地及项目建成后形成的相关房产作为本次申请银团贷款的抵押物。具体贷款金额、贷款期限以公司与银行实际签订的协议为准。

2、为满足江西景旺“高密度、多层、HDI 电路板产业化项目（三期）第一阶段”项目建设资金需求，江西景旺拟向中国银行深圳南头支行、招商银行股份有限公司南昌分行（以下简称“招商银行南昌分行”）、中国农业银行股份有限公司吉水县支行（以下简称“中国农业银行吉水县支行”）申请总额度不超过 12.20 亿元、期限不超过 96 个月的中长期银团贷款，其中中国银行深圳南头支行作为银团牵头行，承贷份额不超过 6.80 亿元、招商银行南昌分行承贷份额不超过 2.40 亿元、中国农业银行吉水县支行承贷份额不超过 3.00 亿元，中国银行股份有限公司吉水支行是代理行。江西景旺拟以其持有的位于吉水县城西工业区金工大道东侧土地及项目建成后形成的相关房产作为本次申请银团贷款的抵押物。具体贷款金额、贷款期限以公司与银行实际签订的协议为准。同时公司拟为江西景旺本次银团贷款提供连带责任担保。

二、2024 年度为子公司提供担保额度预计情况

为进一步改善子公司资产负债结构，提升资金流转效率，满足子公司项目建设及生产经营资金需求，公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于预计 2024 年度向银行申请综合授信及银团贷款暨为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为子公司申请上述综合授信业务及银团贷

款提供合计不超过人民币 33.30 亿元的担保额度，担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等。该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保，担保范围为子公司在银行实际办理的综合授信业务及银团贷款所形成的债权本金及相关利息。具体情况以公司及子公司与银行签订的业务协议为准。担保额度有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日为止。在上述授权期限内，担保额度可循环使用。本次担保事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，并签署相关协议和文件。

上述担保额度为基于公司目前业务情况的预计，实际发生的担保总额以公司及子公司与银行签署的合同为准。公司在预计的担保额度范围内可根据公司及子公司经营情况内部调剂使用，调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。

三、被担保人基本情况

公司名称	法定代表人	注册资本	经营范围	主要财务数据
江西景旺	卓勇	人民币 80,000 万元	新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子元器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板）制造及销售，半导体、光电子器件、新型电子元器件电子产品用材料制造及销售，碱式氯化铜、氢氧化铜、氢氧化锡产品的生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 491,923.85 万元，负债总额 142,270.09 万元，资产净额 349,653.76 万元，营业收入 377,136.84 万元，净利润 85,516.81 万元。
龙川景旺	刘羽	美元 3,700 万元	生产和销售自产的新型电子元器件（片式元器件、敏感元器件及传感器、频率控制与选择元件、混合集成电路、电力电子元器件、光电子器件、新型机电元件、高密度互连积层板、多层挠性板、刚挠印刷电	截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 538,362.74 万元，负债总额 191,539.30 万元，资产净额 346,823.45 万元，营业收

			路板及封装载板)。产品出口外销及中国境内销售。	入 421,220.27 万元,净利润 24,664.80 万元。
珠海景旺柔性	邓利	人民币 65,000 万元	柔性线路板、电子元器件及其零配件的生产、销售。	截至 2023 年 12 月 31 日,资产总额 73,361.85 万元,负债总额 34,733.66 万元,资产净额 38,628.18 万元,营业收入 51,345.28 万元,净利润-5,403.55 万元。
珠海景旺	邓利	人民币 300,000 万元	研发、生产和销售印制电路板、柔性线路板,半导体、光电子器件、电子元器件的表面贴组装加工业务,对外贸易进出口业务。(涉及前置许可的除外及国家有专门规定的除外)。	截至 2023 年 12 月 31 日,资产总额 388,743.52 万元,负债总额 147,767.73 万元,资产净额 240,975.79 万元,营业收入 140,779.58 万元,净利润-23,444.65 万元。

四、担保协议主要内容

上述担保为拟担保授权事项,相关子公司尚未签订具体担保协议,本担保事项尚需提交公司股东大会审议,公司将在股东大会审议通过后,在上述担保额度内根据实际资金需求与银行签订相关协议。

五、担保的必要性和合理性

公司本次预计担保额度是为了满足子公司 2024 年度的经营发展需要,符合公司整体发展战略和整体利益。本次被担保方均为公司合并报表范围内的子公司,资信状况良好,担保风险可控,不存在损害上市公司和全体股东利益的行为。

六、董事会意见

公司及子公司申请银行综合授信及银团贷款并提供担保事项充分考虑了公司及子公司正常生产经营的需求,有利于推动公司及子公司的发展,符合公司整体发展的需要。本次担保是在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上做出的决定,符合公司整体的利益,不存在与法律、法规等相关规定相违背的情况,不存在损害公司股东利益的情形,担保风险在可控范围内。公司董事会全体董事一致同意本次申请银行综合授信及银团贷款并提供担保事项。

七、保荐机构核查意见

保荐机构审阅了公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一次会议相关会议资料、被担保人的财务资料，经核查，保荐机构认为：

1、公司为子公司提供担保融资系为满足其生产经营的正常资金需要，本事项已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，审批程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、景旺电子《公司章程》等相关规定的要求。

2、被担保人均均为公司的控股子公司，生产经营情况、财务情况正常，不存在影响偿债能力的重大或有事项，公司本次为子公司提供担保，不存在损害公司及股东利益的情形。

3、保荐机构对景旺电子 2024 年拟向子公司提供担保事项无异议。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日